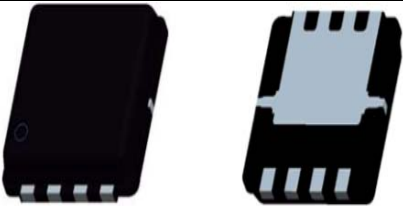
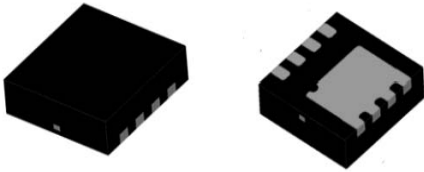




Title of Change:	WDFN 3.3 x 3.3 Capacity Expansion in ON Semiconductor Tarlac, Philippines (OSPI-Tarlac) from ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSCP – Cebu).	
Proposed First Ship date:	26 Nov 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or RamilAngelo.Nonato@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Parts are identified by unique Site Code	
Change Category:	Assembly Change, Test Change	
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Cebu, Philippines	None	
ON Semiconductor Tarlac, Philippines		
Description and Purpose:		
ON Semiconductor, Tarlac Philippines (OSPI- Tarlac) announces the qualification of WDFN 3.3 X 3.3 Sawn package as additional site for Assembly & Test besides ON Semiconductor - Cebu.		
The purpose of this project is mainly for capacity expansion to support the growing demand/volume.		
At the end of FPCN approval cycle, the products will be dual sourced at ON Semiconductor Cebu, Philippines (OSCP Cebu) & ON Semiconductor Tarlac, Philippines (OSPI Tarlac).		
There is no change in form, fit & function of the devices to be produced at this additional site.		
	Before Change Description	After Change Description
LeadFrame	Copper leadframe with NiPdAu plated	Copper leadframe with NiPdAu plated
Bond Wire	2 mils, Copper	2 mils, Palladium Coated Copper
Molding Compound	CEL-9220HF13	EME-G770HM Type D
Lead Finish	NiPdAu	NiPdAu
Assembly & Test Site	ON Semiconductor - Cebu	ON Semiconductor – Cebu ON Semiconductor – Tarlac
Marking	Ex-Fairchild Marking	Cebu – ON Semiconductor Marking Tarlac – ON Semiconductor Marking



Package type of parts assembled from ON Semiconductor Tarlac (OSPI Tarlac) is Sawn Package while parts assembled from ON Semiconductor-Cebu will have Punch Package type. Stamp-off (-L701) will be added to the OPN name in Tarlac site.

	ON Semiconductor – Cebu	OSPI – Tarlac
Package Type	Punch Package	Sawn Package
Package Drawing		
Sample OPN Name	FDMC3612	FDMC3612-L701

Qualification Plan:

QV DEVICE NAME: FDMC86102L, FDMC7664, FDMC6679AZ, FDMC8854, FDMC3612, FDMC8327L, FDMC86244

PACKAGE : WDFN 3.3 X 3.3

Test	Specification	Condition	Interval
HTGB	JESD22-A108	Ta = 150C, Vgs = 25V, 100% of Rated V	1008 hrs
HTRB	JESD22-A108	Ta = 150C, Vds = 24V, 80% of Rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150C	1008 hrs
PC	J STD020, JESD22-A113	IR reflow at 260C	-
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85%RH, ~18.8 psig, Vds = 24V, 80% of rated V or 100V max	192 hrs
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55C to + 150C	1000cyc
UHAST+PC	JESD22-A118	Temp = 130V, RH = 85%, ~18.8 psig, unbiased	96 hrs
IOL+PC	MIL STD750, M 1037 AECQ101	Ta = 25C, delta Tj = 100C max, 2 mins	15000cyc
RSH	JESD22-B106	Ta = 265C, 10 sec dwell B106	-

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
FDMC4435BZ	FDMC6679AZ
FDMC4435BZ-F127	FDMC6679AZ
FDMC6675BZ	FDMC6679AZ
FDMC7678	FDMC7664
FDMC7696	FDMC7664



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN23190X

Issue Date: 26 May 2020

FDMC3612	FDMC3612
FDMC5614P	FDMC3612
FDMC8015L	FDMC8854
FDMC8327L	FDMC8327L
FDMC86106LZ	FDMC86102L
FDMC86116LZ	FDMC86102L
FDMC8622	FDMC86102L
FDMC86244	FDMC86244
FDMC0310AS-F127	FDMC7664

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

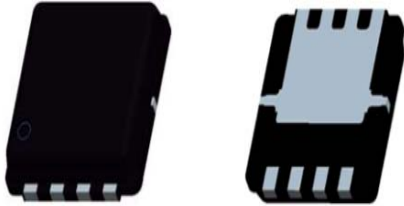
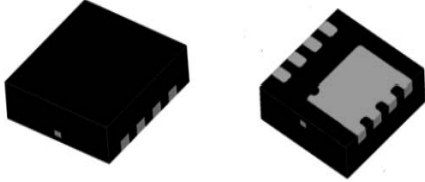
文書番号# : IPCN23190X

発行日: 26 May 2020

変更件名:	WDFN 3.3 X 3.3 の生産能力が、オン・セミコンダクター セブ(フィリピン) (OSCP – Cebu) に加え、オン・セミコンダクター、タルラック(フィリピン) (OSPI-Tarlac) に拡大されます。	
初回出荷予定日:	26 Nov 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または RamilAngelo.Nonato@onsemi.com にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.samples@onsemi.com にお問い合わせください。サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら PCN.Support@onsemi.com にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	部品は固有拠点コードによって識別されます	
変更カテゴリ:	アセンブリの変更, 試験の変更	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Cebu, Philippines	なし	
ON Semiconductor Tarlac, Philippines		
説明および目的:	<p>オン・セミコンダクター セブに加え、WDFN 3.3 X 3.3 Sawn パッケージの組み立て/テストの追加拠点として、オン・セミコンダクター OSPI タルラックが認定されます。</p> <p>本プロジェクトの目的は主に、生産能力を拡大して増加する需要/数量に対応することにあります。</p> <p>FPCN 承認サイクルが完了した時点で、該当の製品は オン・セミコンダクター セブ(フィリピン) (OSCP Cebu) と オン・セミコンダクター、タルラック(フィリピン) (OSPI-Tarlac)のいずれかから供給されることになります。</p> <p>本追加拠点で製造されるデバイスの形状、適合性、機能に変更はありません。</p>	
	変更前の表記	変更後の表記
リードフレーム	Copper leadframe with NiPdAu plated	Copper leadframe with NiPdAu plated
ワイヤ	2 mils, Copper	2 mils, Palladium Coated Copper
モールド・コンパウンド	CEL-9220HF13	EME-G770HM Type D
アセンブリ/テスト拠点	ON Semiconductor - Cebu	ON Semiconductor – Cebu ON Semiconductor – Tarlac
製品表示変更	Ex-Fairchild Marking	Cebu – ON Semiconductor Marking Tarlac – ON Semiconductor Marking



ON Semiconductor Tarlac (OSPI Tarlac) から組み立てられた部品のパッケージタイプは Sawn Package ですが、ON Semiconductor-Cebu から組み立てられた部品のパンチパッケージタイプになります。Tarlac サイトの OPN 名にスタンプオフ (-L701) が追加されます。

	ON Semiconductor – Cebu	ON Semiconductor Tarlac (OSPI – Tarlac)
パッケージ型式	Punch Package	Sawn Package
パッケージ図面		
OPN 名の例	FDMC3612	FDMC3612-L701

認定計画:

デバイス名: FDMC86102L, FDMC7664, FDMC6679AZ, FDMC8854, FDMC3612, FDMC8327L, FDMC86244

パッケージ: WDFN 3.3 X 3.3

テスト	規格	条件	間隔
HTGB	JESD22-A108	Ta = 150C, Vgs = 25V, 100% of Rated V	1008 hrs
HTRB	JESD22-A108	Ta = 150C, Vds = 24V, 80% of Rated V	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta = 150C	1008 hrs
PC	J STD020, JESD22-A113	IR reflow at 260C	-
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85%RH, ~18.8 psig, Vds = 24V, 80% of rated V or 100V max	192 hrs
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55C to + 150C	1000cyc
UHAST+PC	JESD22-A118	Temp = 130V, RH = 85%, ~18.8 psig, unbiased	96 hrs
IOL+PC	MIL STD750, M 1037 AECQ101	Ta = 25C, delta Tj = 100C max, 2 mins	15000cyc
RSH	JESD22-B106	Ta = 265C, 10 sec dwell B106	-

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FDMC4435BZ	FDMC6679AZ
FDMC4435BZ-F127	FDMC6679AZ
FDMC6675BZ	FDMC6679AZ
FDMC7678	FDMC7664
FDMC7696	FDMC7664
FDMC3612	FDMC3612



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN23190X

発行日 : 26 May 2020

FDMC5614P	FDMC3612
FDMC8015L	FDMC8854
FDMC8327L	FDMC8327L
FDMC86106LZ	FDMC86102L
FDMC86116LZ	FDMC86102L
FDMC8622	FDMC86102L
FDMC86244	FDMC86244
FDMC0310AS-F127	FDMC7664